

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 3 区分

【発行日】平成28年10月6日(2016.10.6)

【公開番号】特開2015-46714(P2015-46714A)

【公開日】平成27年3月12日(2015.3.12)

【年通号数】公開・登録公報2015-016

【出願番号】特願2013-176020(P2013-176020)

【国際特許分類】

H 0 1 P 1/04 (2006.01)

H 0 1 P 5/02 (2006.01)

【F I】

H 0 1 P 1/04

H 0 1 P 5/02 6 0 3 F

【手続補正書】

【提出日】平成28年8月19日(2016.8.19)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

第 1 基板と、

前記第 1 基板上に配置された第 1 信号線路と、

前記第 1 基板と隣接して配置された第 2 基板と、

前記第 2 基板上に配置された第 2 信号線路と、

前記第 1 基板上の前記第 2 信号線路の端部と対向する位置に配置され、接地電位と接続される接地パターンと、

前記第 1 信号線路と第 2 信号線路との間を接続する第 1 ボンディングワイヤと、を有することを特徴とする伝送線路。